

Datenblatt Herstellung elektronischer Baugruppen, Assembling



BEGEISTERUNG FÜR ELEKTRONIK

elektronische Baugruppen	Nutzenverarbeitung	
	maximale Größe	443x508 mm
	Fertigungslose	ab 1 Stück
THT	alle Bauformen	
SMD	Löten per Schwallötmaschine oder Hand	
	kleinste Bauform	.0201
	BGA-Bestückung	
	Bestückung per Automat oder Hand	
	Dampfphasenlöten / Reflowlöten	
	Lötpasten- bzw. Kleberdruck mit Jet Print oder Pastenschablone	
Materialbeschaffung	Prüfung auf Verfügbarkeit auch bei Kleinstmengen	
	Einkauf weltweit (u.a. von abgekündigten und schwer beschaffbaren Bauteilen)	
	Verarbeitung von Kundenbestellmaterial	
	umfangreiches Bauteilsortiment am Lager	
Besonderheiten	Montage von Steckverbindern, Kühlkörpern (Schrauben, Nieten)	
	Frontplatten- und Gehäuseeinbau	
	Komplettierung und Verdrahtung	
	Baugruppenverguß / Printschutzlack	
Technische Beratung	Dokumentationserstellung	
	Hilfe bei Bauteil Auswahl	
	Erstellung von CAD-Daten	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	AOI	
	elektrischer Test / Abgleich von Baugruppen	
	Inbetriebnahme nach Kundenwunsch	
	Erstmusterprüfung	
Daten	ODB++	
	Pick- & Place-Listen und Gerberdaten	
	Stücklisten, Bestückungspläne	
	Verarbeitung von Eagle, Target, Gerberdaten	
	Musterplatinen	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2015	
	IPC-A-610 class I und II	
	spezielle Ausführungen auf Anfrage	